

深圳市联得自动化装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2025-008

投资者关系活动类别	☒特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☐业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☒现场参观☒其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	汇丰晋信基金、易方达基金、泓德基金、汇添富基金、华夏基金、银华基金、宝盈基金、南方基金、浦银安盛基金、富国基金、利幄资产、诚旻投资、华泰资产、泰康资产、人保资产、天风证券、华创证券、山西证券、爱建证券、勤辰资产、东北证券、国投瑞银基金、长盛基金、西部证券、臻远投资、西南证券、野村资管、建信基金、国信证券共 30 人
时间	2025 年 5 月 30 日
地点	线上：电话会议 线下：东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：胡金先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：公司这几年发展又快又稳，主要原因是什么？ A1：一是公司坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，并加速技术优势到产品的转化，优化产品结构，实现国产替代。二是公司积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。三是公司持

续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率，不断强化内部协同，提升运营效率。坚持推行降本增效举措，推行精细化成本核算与管理，通过开源和节流相结合，提升人均创利水平。四是优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展。

Q2：公司在三折屏供应链中已经出货哪些设备？

A2：公司在三折屏供应链中，提供了贴合类工艺设备的整体解决方案，已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势，为“中国智造”贡献力量。

Q3：公司在 VR/AR/MR 显示领域主要的产品和客户有哪些？

A3：公司通过不断推陈出新打破技术壁垒，持续自主研发创新，研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，涵盖硅基显示、光波导贴合等众多工艺段，相关产品已与合肥视涯及国际头部终端客户建立了合作关系。

Q4：公司在半导体领域是如何布局？

A4：公司目前在半导体行业领域的设备主要集中在芯片封装测试设备领域，主要有显示驱动芯片 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、贴膜机、引线框架检测机等高速高精的半导体装备。在先进封装制程和第三代半导体相关设备领域，在市场和技术等方面，公司也正在布局拓展。公司将持续加大对半导体的研发投入，进一步完善新业务板块产业布局，推动公司半导体设备业务板块的发展。

Q5：公司在 Mini/Micro LED 显示领域进展情况如何？

A5：公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

Q6：公司是否考虑通过并购重组来扩大经营？

A6：公司一直持续关注相关行业动态，积极寻求整合优质资源的机会，将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向，公司将根据自身发展战略规划、市场需求、行业前景等方面审

	慎决策。
附件清单（如有）	无
日期	2025-5-30